2026/09/22

半導體設備　　初次評等

光焱科技 (7728 TT)　　買進(Buy)

光焱從科研走向半導體檢測設備，迎來矽光子商機

- **光焱已通過指標性客戶 RD 段工程驗證，進入量產前驗證**
- **4Q26-1H27 光焱預計取得首批 NightJar-H 量產型設備訂單**
- **1Q-2Q28 路竹二廠預計完工，2H28 增加 3,300 坪生產空間**

光焱已通過指標性客戶 RD 段工程驗證，將進入客戶量產前驗證：光焱於 9/17 舉行法說會。4Q25 光焱矽光子檢測設備已通過指標性客戶 RD 段工程驗證，包含晶圓廠、檢測服務等客戶，出貨機型為 NightJar 設備，並進入客戶量產 HVM 前驗證，4Q25 毛利率達 70.3% (QoQ +4.7ppts、YoY +3ppts)，主要因半導體檢測設備客製化程度高。2Q26 營運表現，營收 1.1 億元(QoQ +8.4%、YoY +37.4%)，訂單出貨佔比多數為科研量測設備；毛利率 60.6% (QoQ -6.5ppts、YoY -3.8ppts)，季減主要因標準化設備毛利率接近 60%水準；EPS 1.08 元(QoQ -29.4%、YoY +535.3%)。

4Q26-1H27 光焱預計取得客戶首批 NightJar-H 量產型設備訂單：光焱主要產品包含 ProbeInsight 平台(NightJar 系列光損檢測設備)、FireFox 高功率 Burn-in 爐、APD-QE 光電探測器，前兩者量產設備單價區間為 2,200-2,600 萬、700-800 萬元，主要服務晶圓廠客戶 OWAT (PIC 晶圓預篩)、Insertion 1、Insertion 3 等光電測試領域，我們預估光焱將於 4Q26-1H27 取得指標性晶圓廠客戶首批 Insertion 1 量產型訂單，出貨機型為 NightJar-H 設備，將 1:1 搭配 Advantest V93000、FORM、TEL Prober Triton 機型，設備交期約 3-6 個月、毛利率 65-70%，營收貢獻於 2Q-3Q27。

1Q-2Q28 路竹二廠預計完工，光焱 2H28 增加 3,300 坪生產空間：光焱矽光子檢測設備可供應 CPO、NPO 等晶圓廠、檢測服務廠、測試設備商需求，因應既有客戶(車用、科研)、矽光子客戶訂單，管理層已承租路竹科學園區土地，興建路竹二廠，P1 廠使用 1/2 土地、生產面積 3,300 坪(二廠 P1 為一廠 8x 空間)、4 層樓(1-3 樓量產、4 樓預備產能)，並將路竹一廠產能移至路竹二廠。若 P1 廠月產能達滿載狀態，科研設備 350 台、ProbeInsight 設備 250 台。除路竹二廠外，光焱已於 9M26 申請取得路竹科學園區 100 坪租賃廠資格，因應短期既有客戶需求，如：車用 CIS 客戶需求，若路竹租賃廠產能滿載，將貢獻年營收達 2 億元以上。

我們 2026-27 年預估 EPS 為 9.3、23 元，基於 2027 年預估 EPS 給予 35 倍 PER，目標價為 800 元，首次給予買進之投資評等建議。

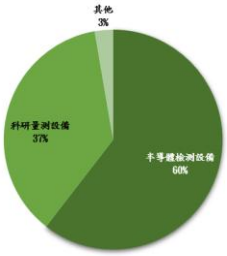
風險因子：矽光子供應鏈量產進度不如預期、車用訂單不如預期。

潛在漲幅	36.5%
前日收盤價	586 元
目標價	800 元
前次目標價	--
前次評等	--

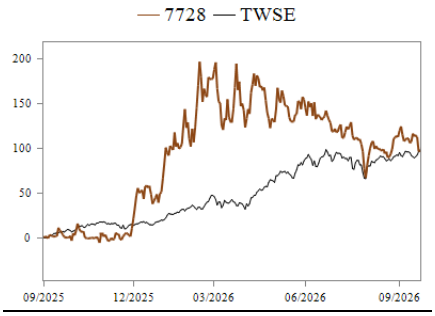
公司基本資訊

目前股本(百萬元)	140
市值(億元)	82
目前每股淨值(元)	52.10
外資持股比(%)	1.37
董監持股比(%)	52.15

1M-8M26 產品別營收佔比



個股與大盤走勢(%)



李柏賢
Fabian.lee@ctbcsis.com

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	233	334	380	357	534	907
營業毛利淨額	153	221	245	235	353	619
營業利益	52	91	108	72	150	388
稅後純益	51	77	108	67	129	319
公告基本 EPS(元)	5.10	6.84	8.79	4.92	--	--
調整後 EPS(元)	--	--	--	4.81	9.33	23.03
營業收入 YoY(%)	40.10%	43.26%	13.90%	-6.16%	49.57%	69.96%
稅後純益 YoY(%)	117.06%	51.08%	41.00%	-38.21%	93.31%	146.74%
本益比	--	--	--	110.29	63.44	25.71
本淨比	--	--	--	10.01	10.71	10.28
股息(元)	--	5.61	7.03	5.00	8.39	20.73
殖利率(%)	--	2.00%	2.52%	0.71%	1.43%	3.54%
ROE(%)	30.69%	31.86%	35.37%	12.40%	17.02%	40.79%

公司介紹：光焱科技股份有限公司(7728.TT，以下簡稱光焱)成立於 2009 年 3 月，資本額 1.39 億元，總部位於高雄路竹區，為科學研究、半導體光電測試設備供應商，主要產品已獲得台灣、中國、歐美等大學、學術研究機構、半導體產業採用。光焱於 2023 年 11 月公開發行、2024 年 3 月登錄興櫃，並於 2025 年 3 月上櫃掛牌。

- **2011-19 年**：光焱成為 IEC 國際電工委員會全球推薦光譜響應測試品牌、通過 ISO17025 認證，取得全球少數光電校正實驗室資格、取得太陽能電池光譜響應與量子效率測量實驗室資格。
- **2020-22 年**：光焱影像感測器測試系統獲得車用電子、消費性電子客戶採用；印度航天太空計劃採用光焱人造模擬光源、影像感測晶片檢測方案。
- **2023 年**：光焱 LiDAR 光傳感器，如：SPAD、SiPM，可檢測晶圓級解決方案，獲得國際晶圓大廠採用、CIS 影像感測器檢測設備解決方案 SG-A 成功切入全球第二大 CIS 廠客戶。
- **2024-26 年**：光焱切入矽光子檢測設備供應鏈。

核心技術：光焱技術研發路線從過往太陽能產業檢測設備，轉型研發至量產 CIS、LiDAR、SPAD、CPO 等檢測設備解決方案。

- **模擬光源**，如：太陽光、高階可控各式模擬光源，可於特殊環境、條件光源照射，以加速研發、產品開發流程、生產品質控制及改善。
- **光電轉換效率檢測技術**，包含光電轉換量子效率光譜、光電轉換噪聲、主光角等，協助客戶精確評估光電轉換性能。
- **晶圓級光電檢測技術**，為一款高精度、高靈敏度、高速度的設備，可直接於多種光學影像感測器上進行晶圓級光電參數檢測，如：模擬光源、量子效率檢測、光缺陷檢測設備都有能力整合至探針台(Prober)或 ATE 測試機台。

圖表一、光焱三大核心技術



資料來源：光焱、中信投顧整理

兩大事業部：光焱分為兩大事業部，分別為科研事業部、半導體事業部，管理層預計 2026 年兩者事業部營收佔比皆為 50%。

- **科研事業部**：光焱提供客製化產品，科研市場設備包含 QE-R (推出至今仍受市場歡迎)、SS-PST、FTPS 等，對標國際大廠如：ThermoFisher、Keysight。

圖表二、光焱科學研究量測設備



資料來源：光焱、中信投顧整理

圖表三、光焱科學研究客戶



資料來源：光焱、中信投顧整理

- **半導體事業部**：光焱提供上中下游產業檢測解決方案，包含光電探測器檢測(PD-QE)等設備、CPO (NightJar、NightJar-H、FireFox、APD-QE)、CIS (SG-A)、SPAD (SPD2200)、晶圓級量測(SG-O)。

圖表四、光焱半導體檢測設備產品



資料來源：光焱、中信投顧整理

矽光子設備展望：2027-28 年矽光子產業有望達商業化量產階段，設備商需於 2026-28 年提前準備產能，並注意以下事項：

- 提早發現製程問題，提升 K.G.D.數量。
- 降低成本，對應元件單價、製程良率。
- 提升良率，對應製程中提升檢測設備能力。
- 光焱檢測設備專注於 CP 檢測、K.G.D.檢測，並非限定於 PIC 晶圓檢測，而是讓整體供應鏈上下游看到光學參數，如：光學特徵。

圖表五、光焱檢測技術可涵蓋 Pluggable、NPO、CPO



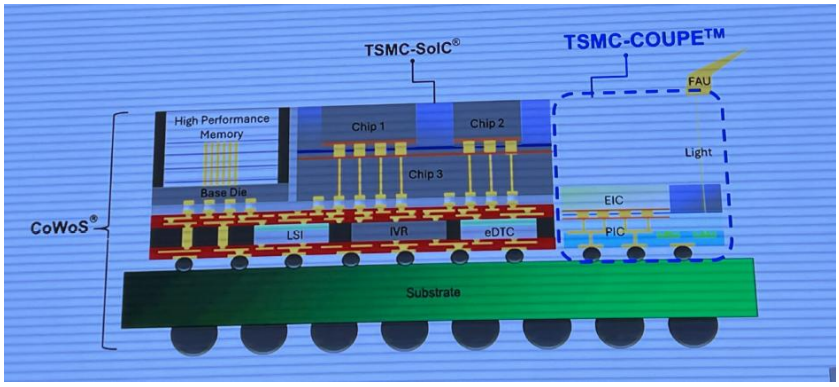
資料來源：光焱、中信投顧整理

CPO 測試、檢量測供應鏈：隨 AI、HPC 資料中心架構中，矽光子技術(Silicon Photonics)扮演著突破頻寬、功耗瓶頸的核心角色，自傳統資料中心依靠「插拔式光收發模組」與 PCB 連接，台積電(2330)推出 COUPE (Compact Universal Photonic Engine)技術，將 CPO 晶片與 GPU、ASIC、HBM 等晶片透過 CoWoS、SoW-X、SoIC-X 技術置於 Interposer 上。基於光訊號再通過光學元件、光纖、光波導連接介面所造成的功率損耗(dB)，使用插入測試損失(Insertion Loss)作為技術成敗關鍵指標，如：過高 Insertion Loss 會造成光功率不足、影響訊號完整性(Integrity)。

- **OWAT (Optical Wafer Acceptance Test, CP1)**：晶圓級測試，光焱不僅服務 CPO 客戶，亦有提供 NPO 或其他晶圓廠客戶測試 PIC 晶圓需求，採用預篩檢測方式。
- **Insertion 1**：晶圓級測試，光晶圓(PIC)、電晶圓(EIC)晶圓階段利用光學探針台、測試機、調變器檢測設備、光偵測器等設備，進行測試、檢測晶圓初始的光功率、Insertion Loss，達到早期篩除瑕疵晶粒。
- **Insertion 2**：晶圓級測試，EIC 晶圓切割為晶片(Die)形式後逐一放置、接合於目標 PIC 晶圓上，進行異質整合封裝技術，如：SoIC-X，使用 Double-sided Probing 上電下光測試，對應測試訊號完整性、電光轉換效能等項目。
- **Insertion 3**：晶片級測試，晶圓切割成為光電晶片(OE Die，稱為光引擎)後，導入 FAU、Receptacle、透鏡(Lens)等光學介面技術，及六軸奈米級主被動對位、耦合等封裝技術進行 Insertion Loss 測試。

- **Insertion 4**：模組級測試，針對 XPU、ASIC 與 OE 組合後模組，完成最終封裝後成為 AI 資料中心 CPO 系統模組，進行 Insertion Loss 測試，包含高溫、高壓等極端環境下系統級光電效能、頻寬等可靠度驗證。

圖表六、TSMC COUPE 封裝技術



資料來源：台積電、中信投顧整理

圖表七、Insertion 1-4 設備供應商

	測試項目	測試要求	測試設備供應商
Insertion 1	晶圓級測試	1. EIC：傳統電性測試 2. PIC：漏光量、漏光處	Triton 組合設備：Advantest + TEL + FORM + 光焱
Insertion 2	晶圓級光電同測	上電下光晶圓級測試	1. ficonTEC WLT-02 + Teradyne 2. 旺矽 TS3500-DS + Advantest
Insertion 3	晶片級測試	下電上光晶片級測試	1. Tester：ficonTEC、致茂、旺矽 DTS650-DI 2. Burn-in 爐：致茂、光焱
Insertion 4	模組級測試	FT + Burn-in + SLT 測試	1. ATE：Advantest、Teradyne 2. Handler：致茂、鴻勁

資料來源：中信投顧整理

光焱矽光子檢測設備：光焱檢測設備可用於 CPO、NPO 等矽光子領域，包含 ProbeInsight、FireFox、APD-QE 三大產品。

圖表八、光焱矽光子檢測設備



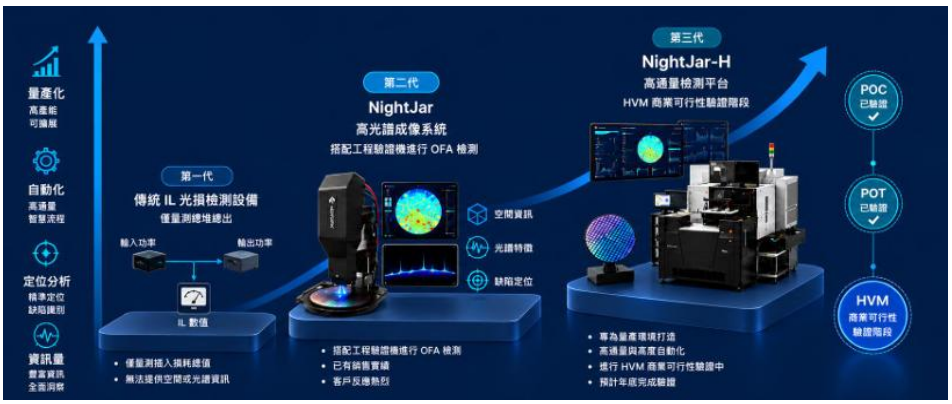
資料來源：光焱、中信投顧整理

- **ProbeInsight 平台**：目前主打 NightJar 系列，分別為 NightJar (實驗室設備)、NightJar-H (量產設備)，對應兩者設備單價區間 1,200-1,600 萬、2,200-2,600 萬。

  - **NightJar 高光譜成像系統**：實驗室設備，2026 年搭配客戶實驗室生產線，如：FORM CM300 機台、失效分析機台(FA)，檢測功能包含定量定位分析(漏光處)、定性分析(波長)、定量分析(漏光量)、預掃描(Pre-scan)、晶圓 Mapping、光損分析(Optical Loss Analysis)，提升 PIC 晶圓檢測良率核心解決方案。

  - **NightJar-H 高通量檢測平台**：量產型設備，可搭配客戶量產 Prober、Tester，NightJar-H 設備單價高於 NightJar 設備單價 70-80%，檢測功能包含高通量(High Throughput)、高自動化(High Automation)、數據融合與 AI 分析(Data Fusion & AI Analytics)。目前進度為 HVM 驗證與量產準備，預計 2026 年底完成客戶驗證，應用於 OWAT (PIC 晶圓預篩)、Insertion 1、Insertion 1.5。

    圖表九、光焱 ProbeInsight 平台：傳統 IL 光損設備、NightJar、NightJar-H

    資料來源：光焱、中信投顧整理

    圖表十、光焱 NightJar 設備進行晶圓級 Mapping 檢測技術

    資料來源：光焱、中信投顧整理

- **FireFox 高功率可靠度驗證系統**：隨矽光子進入量產階段，客戶傾向優化測試流程、加速良率提升、降低測試成本，於老化測試時，設備必須具備連續且零漂移(drift-free)的光注入能力、無需人工手動重新校準，對於大批量 PIC 製造中建立有效的元件劣化模型(Degradation modeling)是絕對不可或缺。光焱設備可對應 OWAT、Insertion 1、Insertion 1.5、Insertion 2、Insertion 3、Insertion 4 客戶生產線所需 PIC 光源 Burn-in 爐、高功率測試光源，可搭配客戶實驗室、生產線既有設備，及測試設備供應商機台，檢測項目包含 1310 奈米雷射光、Burn-in

Test、高功率應力測試(Stress Test)。該設備單價區間為 700-800 萬。

圖表十一、光焱 FireFox 設備



資料來源：光焱、中信投顧整理

- **APD-QE 光電探測器特性與性能測試系統**：光焱矽光子附加價值提升產品線，檢測功能包含 QE 量測、光譜響應(Spectral Response)、光電轉換效率(Photo-to-Electron Conversion)，對應精準的光電探測器性能表現，可應用於矽光子中 PD Array 性能測試。

圖表十二、光焱 APD-QE 設備



資料來源：光焱、中信投顧整理

產能展望：光焱生產基地主要位於高雄市路竹科學園區，包含路竹一廠、路竹二廠、路竹承租廠。路竹二廠量產後，路竹一廠將轉為實驗室給予客戶驗證。

- **路竹一廠**：400 坪、承租廠，光焱成立於 2009 年，生產精密光學檢測方案設備。未來 1H28 路竹二廠落成後，路竹一廠將作為獨立實驗室、客戶驗證廠區。
- **路竹承租廠**：100 坪，承租廠，2026 年底開始向路竹科學園區承租既有廠房，預計 2027 年量產，4Q26 進行廠房佈建，主要生產既有車用客戶設備。
- **路竹二廠**：3,300 坪、租地自建廠 4 層樓，預計 2026 年動工、1Q-2Q28 完工，將於 2H28 加入量產 1-3 層樓，並保留 4 樓廠區，完工時程優於前次管理層預期 1Q29。該廠滿載月產能為科學研究量測設備 350 台、ProbeInsight 設備 250 台。

圖表十三、光焱路竹廠區



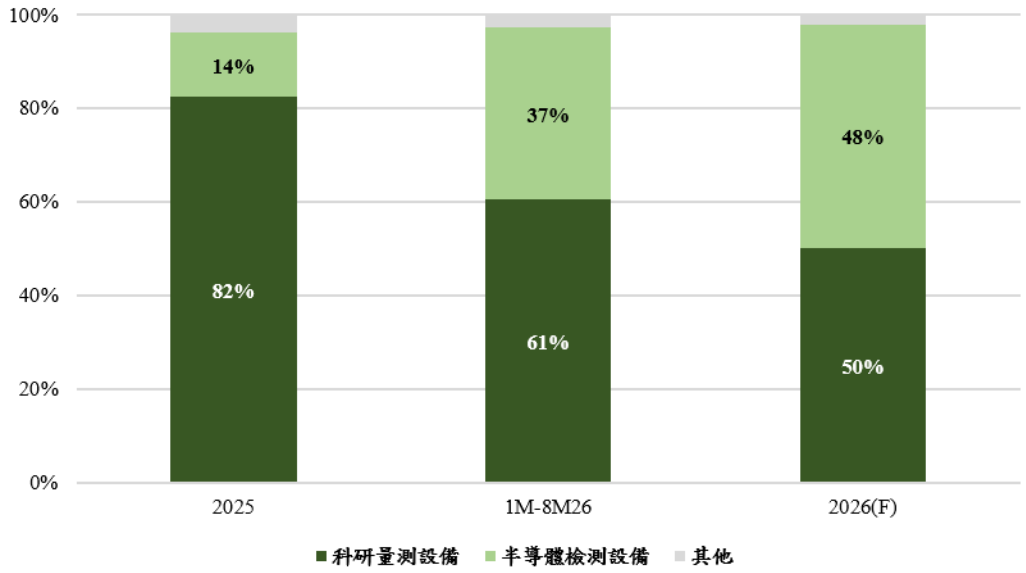
資料來源：光焱、中信投顧整理

圖表十四、2026-28 年產能展望

	地址	生產面積	產能	滿載月產能	營收貢獻
路竹一廠	高雄市路竹科學園區	400 坪	1x	20 台	已量產 （二廠完工後，作為實驗室）
路竹承租廠	高雄市路竹科學園區	100 坪	0.25x	估計中	1Q27
路竹二廠	高雄市路竹科學園區	第一階段：3,300 坪 第二階段：規劃中	8x+	科研設備：350 台 ProbeInsight：250 台	2H28

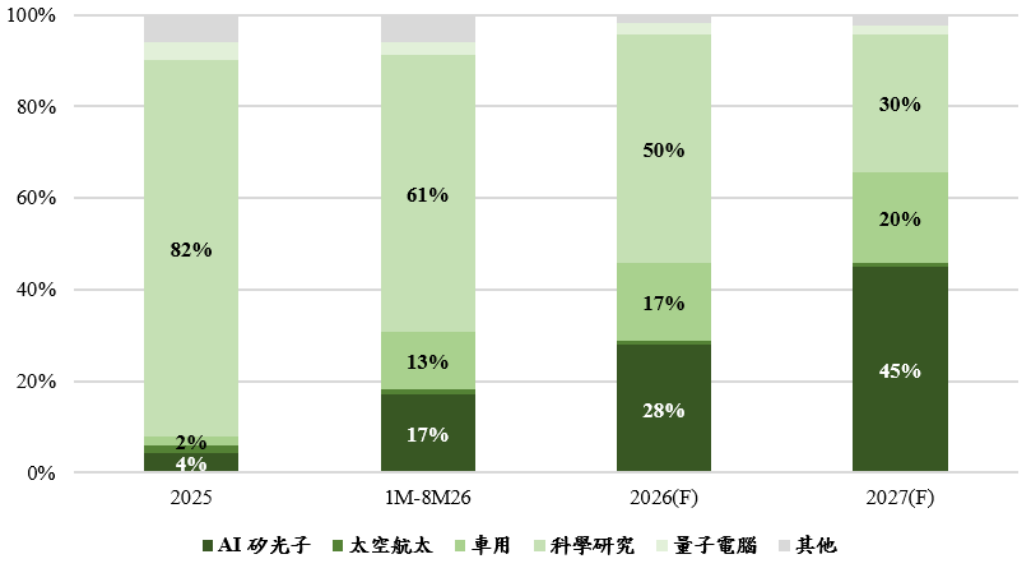
資料來源：光焱、中信投顧整理及預估

圖表十五、2025-26 年產品別營收佔比



資料來源：光焱、中信投顧整理及預估

圖表十六、2025-27 年應用別營收佔比



資料來源：光焱、中信投顧整理及預估

圖表十七、季度財報與預估差異

損益表 (單位：百萬元)	3Q26(F)					4Q26(F)				
	實際數	中信預估	差異	市場共識	差異	調整後	調整前	差異	市場共識	差異
營業收入	-	124	-	108	14.8%	201	-	-	159	26.6%
營業毛利	-	82	-	70	16.2%	139	-	-	103	34.0%
營業利益	-	29	-	26	12.9%	81	-	-	44	84.5%
稅前純益	-	32	-	-	-	84	-	-	-	-
稅後淨利	-	26	-	22	16.9%	67	-	-	36	87.0%
EPS(元)	-	1.86	-	1.56	19.0%	4.86	-	-	2.56	89.8%
財務比率(%/百分點)										
毛利率	-	65.8%	-	65.0%	0.8 ppts	68.8%	-	-	65.0%	3.8 ppts
營益率	-	23.7%	-	24.1%	-0.4 ppts	40.3%	-	-	27.7%	12.7 ppts
稅後淨利率	-	20.8%	-	20.4%	0.4 ppts	33.4%	-	-	22.6%	10.8 ppts

資料來源：CMoney、Bloomberg、中信投顧整理

圖表十八、年度財報與預估差異

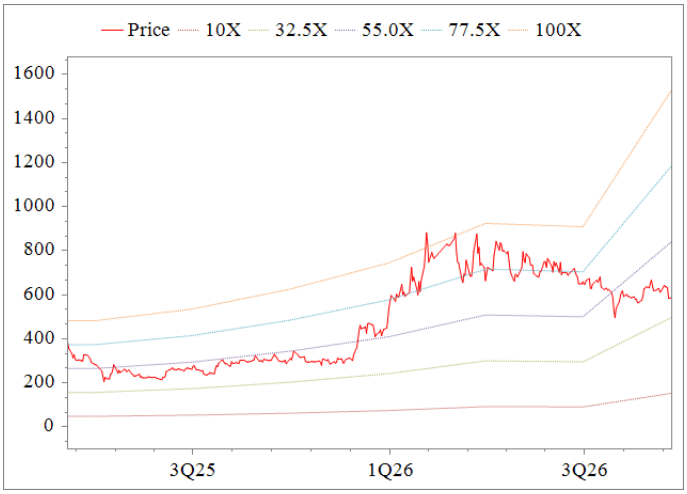
損益表 (單位：百萬元)	2026(F)					2027(F)				
	調整後	調整前	差異	市場共識	差異	調整後	調整前	差異	市場共識	差異
營業收入	534	-	-	475	12.3%	907	-	-	569	59.4%
營業毛利	353	-	-	306	15.3%	619	-	-	367	68.7%
營業利益	150	-	-	109	37.9%	388	-	-	163	138.2%
稅前純益	162	-	-	118	37.1%	399	-	-	170	134.6%
稅後淨利	129	-	-	94	37.6%	319	-	-	135	136.4%
EPS(元)	9.33	-	-	6.71	39.0%	23.03	-	-	9.67	138.2%
財務比率(%/百分點)										
毛利率	66.1%	-	-	64.4%	1.7 ppts	68.2%	-	-	64.4%	3.8 ppts
營益率	28.2%	-	-	22.9%	5.2 ppts	42.8%	-	-	28.6%	14.2 ppts
稅後淨利率	24.2%	-	-	19.8%	4.4 ppts	35.2%	-	-	23.7%	11.5 ppts

資料來源：CMoney、Bloomberg、中信投顧整理

2026/09/22

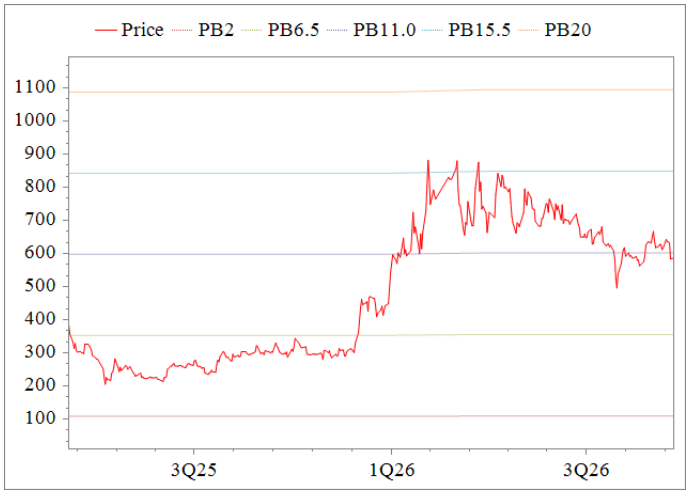
(百萬元)	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
營業收入	100	108	124	201	125	263	276	243
營業成本	33	43	42	63	44	81	86	78
營業毛利	67	66	82	139	81	183	190	165
營業費用	45	48	52	57	60	57	56	56
營業利益	22	18	29	81	21	125	133	109
營業外收支淨額	4	2	3	3	3	3	3	3
稅前純益	26	19	32	84	24	128	136	111
所得稅	5	4	6	17	5	26	27	22
稅後純益	21	15	26	67	19	102	109	89
調整後 EPS(元)	1.53	1.08	1.86	4.86	1.37	7.38	7.85	6.43
毛利率(%)	67.03%	60.56%	65.83%	68.83%	64.94%	69.36%	68.87%	67.90%
營業利益率(%)	22.26%	16.19%	23.69%	40.33%	16.94%	47.56%	48.37%	44.70%
稅後純益率(%)	21.16%	13.97%	20.76%	33.44%	15.22%	38.83%	39.49%	36.66%
營業收入								
QoQ(%)	-22.75%	8.39%	14.40%	62.37%	-37.85%	110.52%	4.63%	-11.85%
YoY(%)	18.02%	37.38%	94.48%	55.54%	25.13%	143.02%	122.27%	20.67%
營業利益								
QoQ(%)	-49.94%	-21.13%	67.33%	176.48%	-73.89%	490.86%	6.41%	-18.53%
YoY(%)	104.21%	29.16%	896.98%	82.67%	-4.73%	613.67%	353.86%	33.74%
稅後純益								
QoQ(%)	-49.56%	-28.44%	69.97%	161.61%	-71.71%	436.95%	6.41%	-18.17%
YoY(%)	55.54%	538.42%	186.12%	60.50%	-9.99%	575.44%	322.86%	32.27%

PER Band



資料來源：中信、CMoney

PBR Band



資料來源：中信、CMoney

2026/09/22

資產負債表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2Q26
資產總計	324	565	456	914	958
流動資產	298	530	421	840	889
現金及約當現金	190	223	322	708	729
應收帳款與票據	23	22	26	45	64
存貨	69	108	56	56	66
採權益法之投資	--	--	--	--	--
不動產、廠房設備	12	10	12	47	45
負債總計	129	278	130	161	236
流動負債	111	270	126	152	227
應付帳款及票據	11	9	8	21	16
非流動負債	18	8	5	9	8
權益總計	196	286	326	753	722
普通股股本	102	123	123	139	139
保留盈餘	64	95	134	104	80
母公司業主權益	196	286	326	753	722
負債及權益總計	324	565	456	914	958

損益表

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	334	380	357	534	907
營業成本	113	135	122	181	288
營業毛利淨額	221	245	235	353	619
營業費用	130	137	163	202	230
營業利益	91	108	72	150	388
EBITDA	95	141	95	207	467
業外收入及支出	5	27	12	11	11
稅前純益	96	135	84	162	399
所得稅	19	27	17	32	80
稅後純益	77	108	67	129	319
公告基本 EPS(元)	6.84	8.79	4.92	--	--
調整後 EPS(元)	--	--	4.81	9.33	23.03

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

現金流量表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2Q26
營業活動現金	52	109	102	81	11
稅前純益	64	96	135	84	19
折舊及攤銷	5	6	11	18	7
營運資金變動	-31	-40	48	-6	-22
其他營運現金	14	47	-92	-16	7
投資活動現金	-17	-159	150	-49	-8
資本支出淨額	-5	-2	-6	-44	-4
長期投資變動	0	-104	102	-5	0
其他投資現金	-12	-52	54	1	-4
籌資活動現金	11	83	-153	354	-1
長借/公司債變動	3	-10	-9	0	0
現金增資	30	40	0	451	0
發放現金股利	-21	-41	-69	-97	0
其他籌資現金	-1	94	-75	1	-1
淨現金流量	46	33	98	386	2
期初現金	144	190	223	322	728
期末現金	190	223	322	708	729

資料來源：中信、CMoney

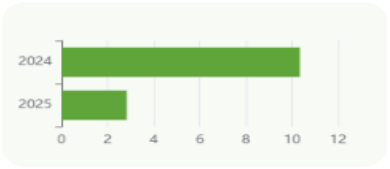
比率分析

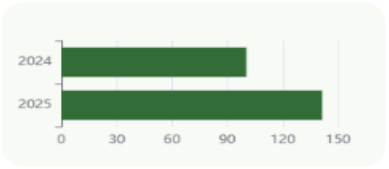
(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
成長力分析(%)					
營業收入淨額	43.26%	13.90%	-6.16%	49.57%	69.96%
營業毛利淨額	43.89%	11.09%	-4.10%	50.12%	75.33%
營業利益	76.31%	19.09%	-33.71%	109.19%	158.26%
稅後純益	51.08%	41.00%	-38.21%	93.31%	146.74%
獲利能力分析(%)					
毛利率	66.09%	64.47%	65.88%	66.12%	68.21%
EBITDA(%)	28.38%	37.02%	26.65%	38.86%	51.50%
營益率	27.28%	28.52%	20.15%	28.18%	42.81%
稅後純益率	23.01%	28.48%	18.75%	24.24%	35.19%
ROE(%)	31.86%	35.37%	12.40%	17.02%	40.79%

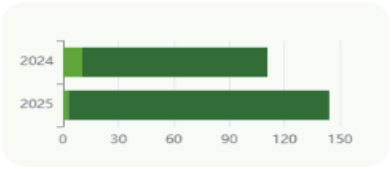
ESG 資訊-環境保護(Environmental)

溫室氣體(範疇一/二)排放量

範疇一	範疇二	總排放量
2.83 (YOY) -72.62%	141.3 (YOY) 40.92%	144.13 (YOY) 30.31%







確信機構：BSI
確信標準：ISO14064-3
確信意見：合理保證等級

確信機構：BSI
確信標準：ISO14064-3
確信意見：合理保證等級

單位：公噸CO_2e

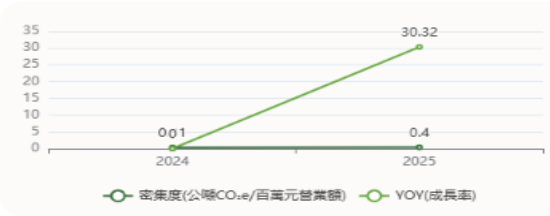
用水量

用水量	104	(YOY) -4.59%
全市場平均	2,114,606.11	(YOY) 16.58%
產業平均	31,744.06	(YOY) 9.73%



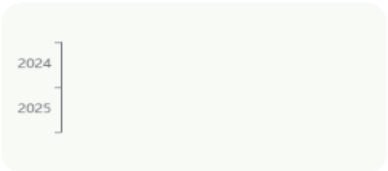
溫室氣體排放密集度

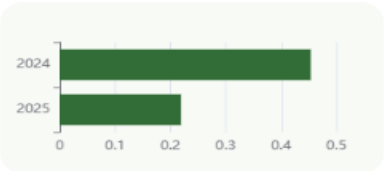
密集度	0.4	(YOY) 30.32%
全市場平均	47	(YOY) -2.65%
產業平均	2.5	(YOY) -11.47%

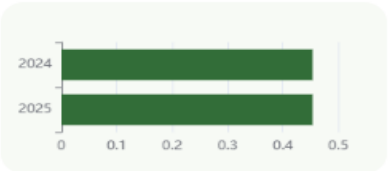


廢棄物量

有害廢棄物	非有害廢棄物	廢棄物總量
NA (YOY) NA -	0.22 (YOY) -51.73%	0.22 (YOY) -51.73%



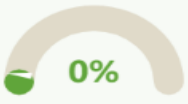




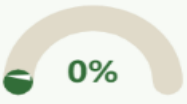
單位：公噸(t)

再生能源使用率

使用率	全市場平均使用率	產業平均使用率
NA (YOY) NA -	3.72% (YOY) 38.11%	0.85% (YOY) 28.61%



2025年
再生能源使用率 0%
全市場平均 3.72%



2024年
再生能源使用率 0%
全市場平均 2.69%

2026/09/22

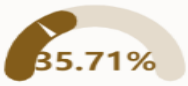
ESG 資訊-環境保護(Environmental)

女性主管占比

占比		全市場平均占比		產業平均占比	
6.89	(YOY) -80.71%	27.88	(YOY) 1.51%	20.42	(YOY) -0.81%



2025年
女性主管占比 6.89%
全市場平均 27.88%



2024年
女性主管占比 35.71%
全市場平均 27.46%

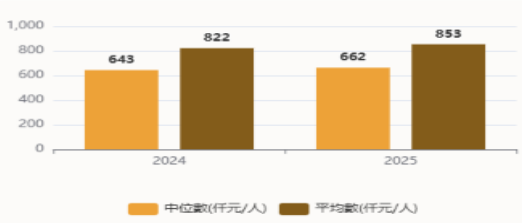
員工薪資年度趨勢

員工薪資平均數		1,066
去年同期	1,061	(YOY) 0.47%
同產業薪資	1,074.37	(YOY) 5.17%



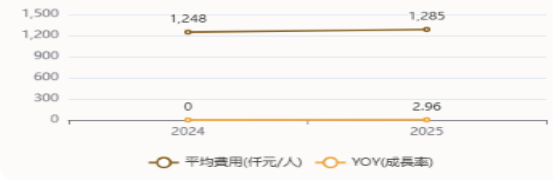
非擔任主管職務之全時員工薪資

平均數	853	(YOY) 3.77%
中位數	662	(YOY) 2.95%
差異	0.22	(YOY) 2.83%



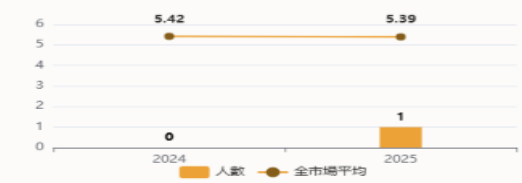
平均員工福利費用

平均費用	1,285	(YOY) 2.96%
全市場平均	1,287.27	(YOY) 2.57%
產業平均	1,248.47	(YOY) 4.07%



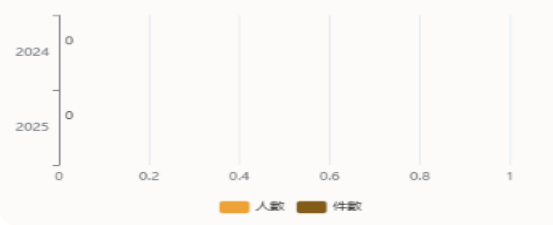
職業災害人數

人數	1	(比率) 1.15%
全市場平均人數	5.39	(YOY) -0.59%
產業平均人數	0.74	(YOY) -90.73%



火災死傷人數與件數

人數	NA	(YOY) NA
件數	NA	(YOY) NA



2026/09/22

ESG 資訊-公司治理(Governance)



資料來源：櫃買中心

2026/09/22

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱"中信金集團"）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司
台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988
營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號